

Patentansprüche

1. Verfahren zum Strukturieren einer unstrukturierten organischen Schicht (3;13), insbesondere von organischen Schaltungen, gekennzeichnet durch

- Aufbringen von Strukturierungsmitteln (2;12) mit einer vorbestimmten Temperatur unter einem vorbestimmten Druck auf die organische Schicht (3; 13); wobei die Strukturierungsmittel (2;12) die organische Schicht (3; 13) berühren und sich an den Berührungspunkten die schichtbildende Substanz der Schicht (3;13) zurückzieht, so dass nach der Berührung Vertiefungen und/oder Löcher 6 ausgebildet sind.

8. Vorrichtung zum Strukturieren von organischen Schichten, insbesondere von organischen Schaltungen, gekennzeichnet durch Strukturierungsmittel (2;12), die vorbestimmte Abmessungen haben; wobei sich die schichtbildende Substanz der Schicht (3; 13) durch Berührung mit den Strukturierungsmittel (2;12) mit einer vorbestimmten Temperatur unter einem vorbestimmten Druck derart zurückzieht, dass Vertiefungen und/oder Löcher 6 ausgebildet werden, die im wesentlichen den Abmessungen der Strukturierungsmittel (2;12) entsprechen.